

2018年11月1日

次世代及び新分野向け IC パッケージ基板の生産能力を増強

当社におきましては、半導体の高機能化・高速化への対応及びサーバー、画像処理などを中心とした新たな需要に対応するため、IC パッケージ基板の生産能力増強を図る目的で、下記のとおり設備投資を実施することを決定いたしました。

今後、半導体市場は、IoT・人工知能(AI)の進展、更には車載向けの展開を背景に拡大が見込まれているとともに、大容量のデータを高速で処理するデータセンターをはじめとしたサーバー向けの需要の高まりも見込まれております。当社におきましては、中期経営計画の達成に向け、新たな需要に確実に対応することで、IC パッケージ基板市場における強固な地位を確立し、電子事業の安定した成長を目指してまいります。

<設備投資の概要(予定)>

- (1) 投資内容：次世代及び新分野向け IC パッケージ基板製造設備
- (2) 投資額：700 億円(2019～2021 年度 合計)
- (3) 設置場所：大垣中央事業場(第2棟)及び大垣事業場(両事業場共に岐阜県大垣市内)
- (4) 稼働時期：2019 年度より順次稼働開始し、2020 年度より量産開始の計画
- (5) 生産能力：本件投資により、IC パッケージ基板の生産能力は、先行して実施している投資の寄与分を含め、2021 年度までに約 50%の増強(層数換算)を計画



大垣中央事業場 第2棟



大垣事業場

以上

【本件に関するお問合せ先】
経営企画部 経営企画グループ
担当: 廣瀬・水谷
Tel: (0584)-81-7973